

2024日本电子科技展NEPCON JAPAN

产品名称	2024日本电子科技展NEPCON JAPAN
公司名称	金正
价格	.00/件
规格参数	简称:东京电子展
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	13122917137 13122917237

产品详情

2024日本电子科技展NEPCON JAPAN

2024日本国际电子科技展览会NEPCON JAPAN

展会时间：2024年01月24-26日（东京）

展会时间：2023年09月13-15日（大阪）

展会规模：约1200家参展商； 参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

展会介绍

作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印刷电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”的场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

展览范围

电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

电子零部件检测设备及开发技术展 ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging Technology EXPO : 装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

电子元件及材料展 ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO : 接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

印刷电路展 PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo : 装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO: 冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

参展联系

联系人：金正经理

作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会